

Shenzhen Deping Electronics co., ltd

深圳德平电子有限公司

产品编号: RG0805A500J1

特点

产品主要运用于微波集成电路模块, 如放大, 耦合、衰减、滤波等模块电路。
降低信号电平、用于负载之间的匹配。低寄生参数、使用频率高。
可焊性与键合性良好。

特性参数

外观: 金属表面光洁, 无外来杂质污染, 瓷体表面无裂痕。金属毛刺小于 20um。
键合性能: 至少承受 6gf 拉力 (25um 直径金丝)。
膜层可焊性: 支持金锡焊接, 5 秒浸润。
膜层耐高温: 400°C 5 分钟、180°C 2 小时不变色, 不气泡。
额定功率: 3W

电阻值	频率 (GHz)	阻值精度	回损最小值
50 Ω	DC-18GHz	±5%	20dB

仅正面金属化

基板材料: 99.6%氧化铝基板, 厚度 0.254mm

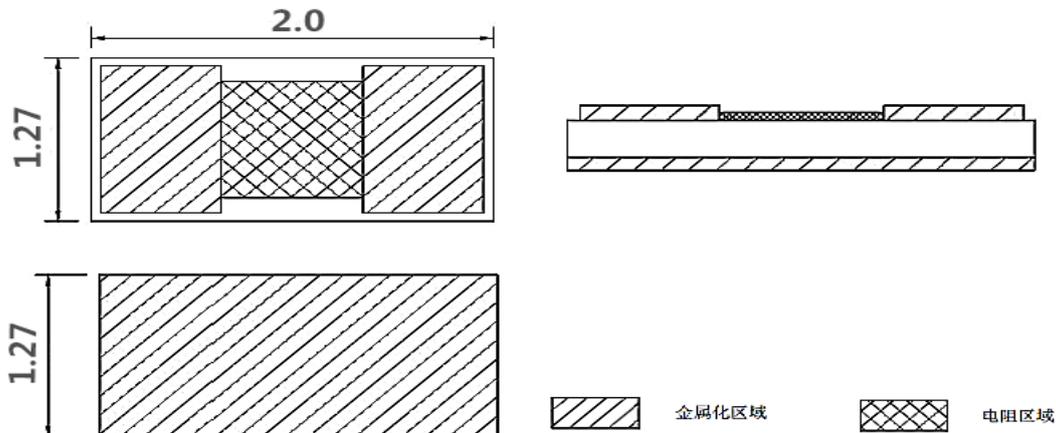
金属化结构: TaN/TiW/Au

TaN: 符合方阻要求

TiW: 300 - 500A

Au: 2.5uM min

尺寸规格 (单位: mm)



电话: 0755-23023733

传真: 0755-85287900

邮件: Xufei66@dephk.com

地址: 深圳市宝安区西乡街道三围航空路 30 号